

证券代码：688709

证券简称：成都华微

成都华微电子科技有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 新华人寿、中邮保险、君康保险、五矿鑫扬、交银人寿、招商信诺、国泰财险、长城财富、众安保险、信达澳亚、华福证券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时间            | 2025 年 6 月 18 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 地点            | 成都华微电子科技有限公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、总经理王策先生，证券事务代表周文明、蔡进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流活动中，来访人员现场参观了公司通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC 认证的国家级检测中心，详细了解了公司产品的生产流程和技术特点。</p> <p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司是国家“909”工程集成电路设计公司，专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向。自“十一五”以来，公司连续承接多项 FPGA、ADC、SoC 方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划，是目前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。</p> <p>目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成</p>     |

电路产品，这些产品可广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个领域。公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC 认证的国家级检测中心，具有较为完备的集成电路产品测试能力。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先地位。

**二、问答情况**

**1. 如何理解公司“3+N+1”平台化产品体系？**

答：公司着力打造“3+N+1”平台化产品体系，是指在超大规模 FPGA、高性能 AD/DA 转换芯片、嵌入式 SoC 与 MCU 三个方向持续强化科研投入，实现技术引领；在 CPLD、存储器、总线接口、电源管理等多个方向以市场需求为导向，推动产业升级。

公司在超大规模 FPGA、高性能 AD/DA 转换芯片、嵌入式 SoC 与 MCU 三个方向齐头并进，可以实现依托公司全系列芯片，为客户提供一系列低价格、低功耗、小体积、高可靠性的 SiP、模块、板级国产化系统解决方案，形成信号处理与控制的成都华微产品生态。

**2. 公司上半年订单恢复情况如何？**

答：就目前来看，公司在手订单情况良好，产线运营稳定正常，上半年业绩请后续关注公司的 2025 年半年度报告。公司积极推动在高性能 FPGA、高速高精度及超高速 ADC 和智能异构 SoC 等方向的布局，所能形成的卡位和定型优势将使得公司充分受益特种集成电路领域的后续发展。公司也将继续深耕特种集成电路研发，持续跟进市场及客户需求，适时拓展产品可能的应用场景，制定前瞻性布局 and 规划，努力把握市场机遇。

**3. 客户对低成本、高性能产品的需求不断提升，公司是怎样应对和布局的？**

答：公司作为国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大

专项的企业，CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC等核心产品在国内有一定领先优势。公司借助在核心产品的优势上，通过采用SoC和SiP形式，能够满足下游客户在小型化、轻量化、低成本及高性能的相关需求，在保持原有产品性能的同时降低其在芯片端采购成本。目前公司SoC和SiP类产品均有销售，未来公司也将继续以客户需求为导向、以解决客户问题为核心，积极推进相关领域的产品布局。

4. 公司自愿披露的4通道12位16G高速高精度射频直采ADC芯片和8位64G超高速AD转换器的应用领域有哪些？

答：公司于2024年12月及近期分别发布了这两款AD转换器产品，均是自主设计，全流程自主安全，性能与国际同类型先进产品相当。8位64G超高速AD转换器产品误码率低、支持DC输入、同时兼具抗辐照能力，可应用于航天、航空、探测、感知、无线通信、激光通信、卫星通信、高端仪器仪表、6G通感一体化等多个领域；4通道12位16G高速高精度射频直采ADC芯片，配套有HWD6952时钟芯片，支持最多10个时钟通道扇出，最多可支持8片HWD12B16GA4型ADC同步采样，可应用于雷达与电子对抗、6G无线通信、光通信、高端医疗设备、高端仪器仪表、无人机等多个领域，是未来应用前景广阔的核心元器件。

5. 公司产品在无人化领域的应用情况如何？

答：公司产品为通用型芯片，覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，相关产品均可运用于无人化相关领域，实现微动控制、边缘计算、飞行控制、视频捕捉等多种功能。

6. 公司目前已与四川具身人形机器人科技有限公司达成深度合作意向，请问具体合作情况是怎样的以及会对公司带来哪些影响？

答：公司于今年初与四川具身人形机器人科技有限公司签署战略合作协议，双方计划基于各自在集成电路、人工智能及机器人领域的核心技术优势，共同推进智能机器人核心部件的国产化研发与应用落地，助

|                       |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>力中国智能机器人产业高质量发展。公司将依托高性能 AI 芯片研发能力，为具身科技量身定制智慧大脑芯片解决方案。</p> <p>目前人形机器人、机器狗等无人化产品均处于高速发展阶段，各厂商都在积极布局。公司通过对人形机器人、机器狗等无人化产品在相关专用场景的应用，充分了解客户需求，提前布局相关前瞻领域，提升产品的研发适配性，增加公司的核心竞争力。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 否                                                                                                                                                                                    |
| 附件清单(如有)              | 无                                                                                                                                                                                    |
| 日期                    | 2025 年 6 月 19 日                                                                                                                                                                      |